

## (4) ペレットのヘマタイト結合機構に関する研究

八幡製鉄東京研究所

立藤真一 佐々木 慎

○中沢孝夫 伊藤 薫

ヘマタイトを原料とするペレットを焼成した場合、原料ホール中の微粒子はペレットの結合強化に決定的な役割をはたす。すなはち原料ホールおよび焼成途次のペレットの綿密な顕微鏡観察を行なつて結果、粗粒子間に介在する10μm以下の微粒子は、焼成過程でちがいに焼結、凝集して小さな granule をつくつてそれが粗粒子間の bridge となり、この bridge の発生、肥大とともにペレットの収縮が進み、強度も向上する事がわかつた。そこで原料鉱石中の微粉含有量をいろいろと變えて焼成ペレットの強度を調べたところ、いくつかの興味ある事実が見出された。

実験に使用した鉱石は脈石分の少ないブラジル鉱石(脈石量約1%)で、これを粉碎して9種類の原料粉に調整した。原料粉の粒度構成は-32.5×ツッシュでは58.7~100%, -10μm含有量では3.3~49.3%である。造粒に

あたっては、適正水分量で造粒時間を長くとって生ホールの密度をできるだけ高くするようにした。えられたホールの充填率は、-10μm含有量の増加とともに上昇するが、それが30%以上では充填率は頭打ちとなることが認められた。焼成はまず shaft 炉を対象にしてゆるやかな昇温速度で焼成したが、Fig-1 に示すように、-10μm含有量が30%

%以下の焼成ペレット強度は、焼成温度と並行して上昇しているが、一方-10μm含有量が30%になると強度は1250℃を頂点に急激な低下を示している。この変化は Fig-2 に示す閉鎖孔率のそれとよく対応している。Fig-2の破線の部分は、冷却後にペレットに亀裂が入ったため閉鎖孔率が減少したものであり、閉鎖孔率が高くなりすぎると熱衝撃により亀裂が生じて強度の低下が起るものと考えられる。一方このように-10μm含有量の高いホールを Travelling Grate 炉を対象とするよう急速昇温焼成を行なつたところ、空孔の閉鎖が起らず、Fig-3 に示すように高温度における強度の低下もなくなることがわかつた。このように10μm以下の微粉がありすぎると、ヘマタイト結合ペレットでは、ある場合には高温焼成はマイナスの効果が現われる。すなはちストラク結合と異なり、ヘマタイト結合は固相で焼結が進むので、その焼結の進行度は最高温度に支配され焼成時間には影響されることはなくそのため急速焼成によっても強度が高く被還元性の優れたペレットがえられるのである。また焼成方法により高温側での強度が低下しないあるいは上昇したりするのは、熱衝撃等による亀裂を招くような限界孔率の存在するところを現わしているものと考えられる。

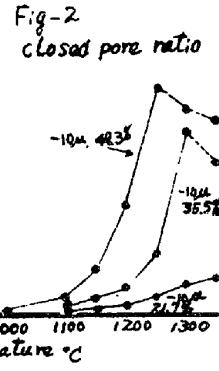
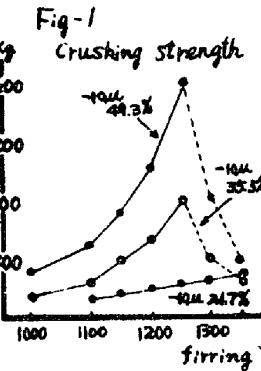


Fig-3

